

タッチパネルの製造工程(例)
[投影型静電容量方式]

回路パターン形成	基板上に透明電極パターンを形成
印刷/硬化 工程	基板周囲の印刷/硬化 など
FPC圧着工程	基板とFPCの圧着工程
貼り合わせ工程	XY基板の貼り合わせ工程
外観・機能検査	外観/機能検査

タッチパネルの製造工程(例)
[表面型静電容量方式]

電極パターン印刷	基板上に周囲電極パターンを印刷
焼成工程	周囲電極パターン等の焼成
レジスト印刷	基板周囲のレジスト印刷
構成部品の取付	その他構成部品の取付 (FPC圧着・ケーブル配線など)
外観・機能検査	外観/機能検査